



2019年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2019年3月29日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 2019年4月12日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2019年5月期第3四半期の業績(2018年6月1日～2019年2月28日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年5月期第3四半期	71,840	32.0	4,524	24.2	4,469	23.9	3,109	26.1
2018年5月期第3四半期	54,416	18.8	3,642	22.4	3,607	23.6	2,466	24.8

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2019年5月期第3四半期	96.80	—
2018年5月期第3四半期	76.77	—

(注)2018年5月期第3四半期累計期間の経常利益は、「固定資産除売却損益」を特別損益から営業外損益に組み替えたことにより、当該組み替えを反映した組替後の数値及び対前期増減率を記載しております。詳細は【添付資料】6ページ「2. 四半期財務諸表及び主な注記 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項(追加情報)(表示方法の変更)」をご覧ください。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年5月期第3四半期	97,524	59,985	61.5
2018年5月期	92,202	57,872	62.8

(参考)自己資本 2019年5月期第3四半期 59,985百万円 2018年5月期 57,872百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2018年5月期	—	14.00	—	14.00	28.00
2019年5月期	—	15.00	—		
2019年5月期(予想)				15.00	30.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2019年5月期の業績予想(2018年6月1日～2019年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	90,000	21.3	5,450	21.1	5,450	23.4	3,700	20.5	115.17

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※対前期増減率は、前事業年度の「固定資産除売却損益」を特別損益から営業外損益に組み替えたことにより、組替後の数値と比較して記載しております。

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2019年5月期3Q	35,497,183株	2018年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2019年5月期3Q	3,370,357株	2018年5月期	3,369,411株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2019年5月期3Q	32,127,343株	2018年5月期3Q	32,128,387株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(日付の表示方法の変更)

「2019年5月期 第1四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(追加情報)	6
(セグメント情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーの生産は引き続き堅調に推移いたしました。また、当社の主要なユーザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資は、底堅く推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は718億4千万円と前年同四半期比32.0%の増収となり、営業利益は45億2千4百万円（前年同四半期比24.2%増）、経常利益は44億6千9百万円（同23.9%増）、四半期純利益は31億9百万円（同26.1%増）となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハーを中心に堅調な生産が継続いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の増加等により、前事業年度末と比較して53億2千1百万円増加し、975億2千4百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により32億9百万円増加し、375億3千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加21億7千8百万円等により、599億8千5百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2018年7月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2019年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,137	17,853
受取手形及び売掛金	29,403	28,852
商品及び製品	1,639	797
仕掛品	845	900
原材料及び貯蔵品	1,738	1,833
その他	1,930	976
貸倒引当金	△13	△6
流動資産合計	56,681	51,208
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	16,555	20,748
機械及び装置(純額)	9,111	17,068
その他(純額)	6,896	5,087
有形固定資産合計	32,562	42,904
無形固定資産	493	547
投資その他の資産		
その他	2,470	2,869
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	2,464	2,863
固定資産合計	35,520	46,316
資産合計	92,202	97,524
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,859	20,965
短期借入金	100	100
未払金	9,072	10,905
未払法人税等	1,364	1,068
引当金	111	531
その他	2,578	2,408
流動負債合計	32,085	35,978
固定負債		
長期借入金	200	125
退職給付引当金	1,348	1,269
その他	695	165
固定負債合計	2,244	1,560
負債合計	34,329	37,538

(単位:百万円)

	前事業年度 (2018年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2019年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	24,894	27,072
自己株式	△4,764	△4,765
株主資本合計	57,732	59,908
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	155	82
繰延ヘッジ損益	△14	△5
評価・換算差額等合計	140	76
純資産合計	57,872	59,985
負債純資産合計	92,202	97,524

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 2017年6月1日 至 2018年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2019年2月28日)
売上高	54,416	71,840
売上原価	47,617	62,447
売上総利益	6,799	9,393
販売費及び一般管理費	3,156	4,868
営業利益	3,642	4,524
営業外収益		
受取利息	2	2
受取配当金	7	8
固定資産売却益	16	44
その他	44	35
営業外収益合計	70	91
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	56	108
その他	47	37
営業外費用合計	104	146
経常利益	3,607	4,469
税引前四半期純利益	3,607	4,469
法人税、住民税及び事業税	1,225	1,838
法人税等調整額	△83	△479
法人税等合計	1,141	1,359
四半期純利益	2,466	3,109

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。また、前事業年度の貸借対照表は当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

(表示方法の変更)

前第3四半期累計期間において、「特別利益」に表示しておりました「固定資産売却益」は第1四半期会計期間より「営業外収益」に、「特別損失」に表示しておりました「固定資産除売却損」は、第1四半期会計期間より「営業外費用」に計上する方法に変更しております。これは、第1四半期会計期間において改めて表示方法を検討した結果、設備の更新等による費用については、今後経常的に発生すると見込まれるため、経常損益に含めて表示することが当社の実態をより適切に表すことになると判断したためであります。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期累計期間の四半期財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前第3四半期累計期間の四半期損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示しておりました16百万円は「営業外収益」の「固定資産売却益」として、「特別損失」の「固定資産除売却損」に表示しておりました56百万円は、「営業外費用」の「固定資産除売却損」としてそれぞれ組み替えております。また、この変更により前第3四半期累計期間の経常利益が3,648百万円から3,607百万円となっております。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第3四半期累計期間(自 2017年6月1日 至 2018年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,143	31,273	—	54,416	—	54,416
セグメント間の内部売上高 又は振替高	16	—	3,543	3,560	△3,560	—
合計	23,159	31,273	3,543	57,976	△3,560	54,416

当第3四半期累計期間(自 2018年6月1日 至 2019年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	34,716	37,123	—	71,840	—	71,840
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	19	6,072	6,093	△6,093	—
合計	34,718	37,143	6,072	77,934	△6,093	71,840